

第31期 中間(第2四半期)報告書

平成27年4月1日から平成27年9月30日まで

証券コード 2760



東京エレクトロン デバイス株式会社

株主の皆様へ



株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社第31期中間報告書(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)として事業の概況等をご報告いたします。

(左)代表取締役社長 徳重 敦之
(右)代表取締役副社長 久我 宣之

当中間期(第2四半期)の経営成績

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資の持ち直しがみられるものの、中国経済の成長が鈍化していることなどを背景に景気の回復は足踏み状態となっております。また、グローバルでも景気後退懸念が強まり、先行きの不透明感が払拭できない状況となっております。

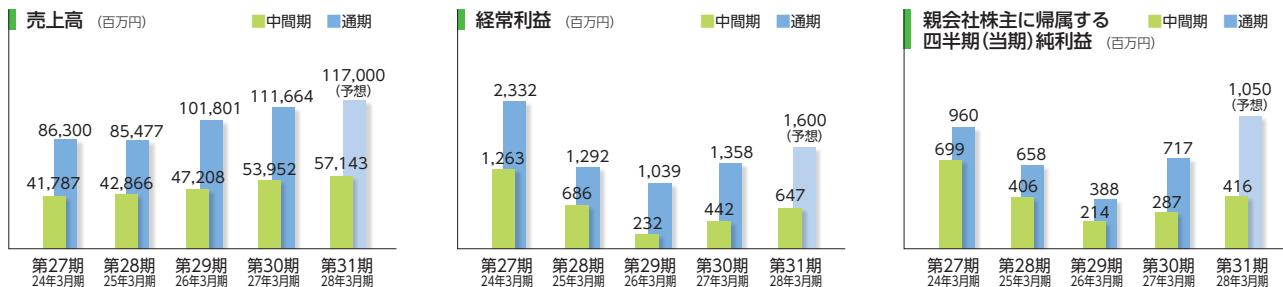
当社グループにおける当中間期の業績については、売上高571億4千3百万円(前年同期比5.9%増)、売上高の増加等に伴い、営業利益7億8千8百万円(前年同期比37.5%増)、経常利益6億4千7百万円(前年同期比46.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益4億1千6百万円(前年同期比44.8%増)となりました。

連結業績予想などの将来予測情報

当中間期の業績は予想を上回る結果となりました。通期の業績見通しについては、売上高が引き続き堅調に推移する一方、当初は見込まれていなかった利益率の低いビジネスの売上構成比に占める割合が拡大する見通しとなることから、利益については据え置くこととし、平成28年3月期通期連結業績予想を次のとおり修正いたします。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回(平成27年4月24日)発表予想(A)	114,000	1,600	1,050	105.31
今回発表予想(B)	117,000	1,600	1,050	105.31
増減額(B-A)	3,000	—	—	—
増減率(%)	2.6	—	—	—
(参考)前期連結実績(平成27年3月期)	111,664	1,358	717	71.99

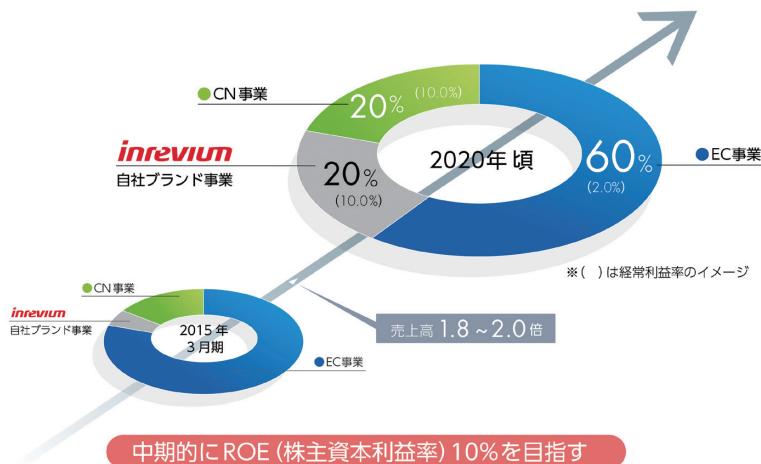
連結業績ハイライト



新たな経営計画

VISION2020 成長に向けた変化への挑戦

当社では、向こう3ヶ年の売上高・経常利益・当期純利益の計画をローリング方式によって毎年公表してまいりました従来の「中期経営計画」に代え、より長期的な目標として2020年頃に照準を合わせた成長イメージを設定し、これを実現するための前提となる事業戦略等を「VISION 2020 成長に向けた変化への挑戦」としてまとめました。



【EC事業(半導体及び電子デバイス事業)】

- 顧客に密着した営業活動を強化し、これまでに培ってきた技術力により差別化を図る

【自社ブランド事業(半導体及び電子デバイス事業)】

- 「inrevium」に関する事業の受託設計・製造サービスを充実
- 競争力のある自社製品の開発を推進
- 技術提携を含めた開発パートナーとの様々な協業体制を構築
- 新しい製品分野への参入と新製品開発に向けた研究開発投資

【CN事業(コンピュータシステム関連事業)】

- クラウドなどに対する先進的な製品ラインナップを充実させ、保守体制のさらなる強化
- 最適なシステム環境を構築できる製品群、信頼される技術サポートを継続的に提供

株主還元について

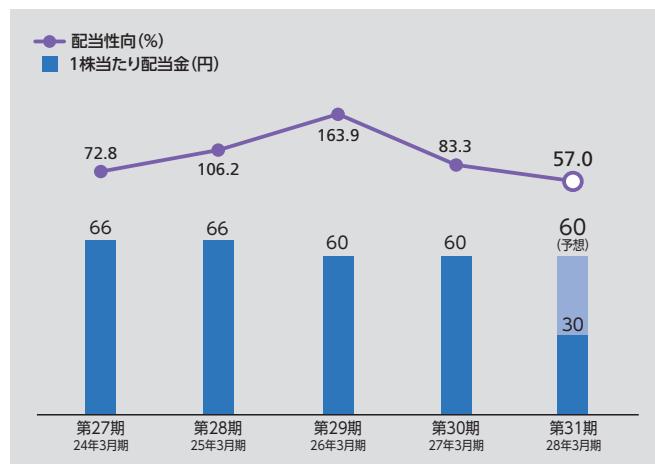
当社は株主重視を経営の最重要事項の1つと位置付けており、株主の皆様に対する利益還元と経営基盤を強化するための内部留保とのバランスを考慮しつつ、株主還元の充実を図ることを基本方針といたします。

従来からの継続的かつ安定的な配当実施に加え、業績を反映した利益還元の視点に基づく配当政策として、これまで配当性向の目安は連結当期純利益の35%程度としておりましたが、この水準を50%以上に引き上げ、かつ経営指標である資本効率を示すROE(株主資本利益率)と連動するDOE(株主資本配当率)*を採用することとし、DOEは2.5%を下限としてまいります。

当中間期の1株当たり配当金は30円とさせていただきます。期末の1株当たり配当金は30円、通期で60円を予定しております。

※DOE(株主資本配当率)

株主資本に対し、どの程度の配当が利益還元として実施されているのかを示す指標であり、「配当性向×ROE」という算定式によって導き出されます。

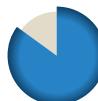


※1株当たり配当金は平成25年10月1日の株式分割(1株→100株)を反映した金額にて記載しております。

半導体及び電子デバイス事業

売上高構成比

85.2%



売上高 48,698百万円

半導体メーカーの再編が進む中、自動車に搭載される電子デバイスの増加やIoT社会の到来等により半導体の需要拡大が見込まれておりますが、中国では産業機器の一部やスマートフォン関連の設備投資に陰りがみられるなど、警戒感が生じております。

このような状況のもと、販売代理店契約解消に伴う売上高の減少があったものの、PC関連製品やPOS端末向けなどの半導体の販売が総じて堅調に推移したほか、車載向けにアナログICをはじめとする半導体の販売に注力した結果、当中間期における売上高は486億9千8百万円(前年同期比3.7%増)、セグメント利益(経常利益)は3億7千5百万円(前年同期比20.1%増)となりました。

品目別売上高構成比



①汎用IC

色々な用途に
使用されるIC



主な商品と仕入先

アナログIC (テキサス・インスツルメンツ社、
リニアテクノロジー社)

主な最終製品

カーナビゲーション、FA機器、医療機器、
OA機器、デジタル家電

②専用IC

特定用途向けに
作られるIC



主な商品と仕入先

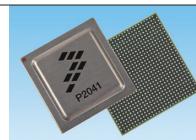
DLP用 (テキサス・インスツルメンツ社)
画像補正用 (ピクセルワークス社)
画像処理用 (インレピアム) **inrevium**

主な最終製品

液晶プロジェクタ、デジタル家電、OA機器、
FA機器、医療機器

③プロセッサ

コンピュータの
頭脳として演算・
制御機能を持つIC



主な商品と仕入先

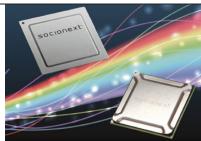
マイクロプロセッサ (フリースケール・セミコンダクタ社、
インテル社)
DSP (テキサス・インスツルメンツ社)

主な最終製品

携帯電話基地局、OA機器、
医療機器、カーナビゲーション

④カスタムIC

お客様の仕様に
応じて作られるIC



主な商品と仕入先

PLD (ザイリンクス社)
ASIC (㈱ソシオネクスト)

主な最終製品

医療機器、FA機器、通信機器、OA機器、
カーナビゲーション

⑤光学部品

電気を光に変換して
使用する電子部品



主な商品と仕入先

LED、フォトカプラ(アバゴ・テクノロジー社)

主な最終製品

携帯電話、車載機器、FA機器

⑥メモリIC

記憶用IC



主な商品と仕入先

FRAM (サイプレス セミコンダクタ社)
フラッシュメモリ (スパンション社)

主な最終製品

FA機器、OA機器、通信機器

コンピュータシステム関連事業

売上高構成比
14.8%



売上高 8,444百万円

企業収益の改善等により、凍結されていたシステム案件が一部で再開される中、「マイナンバー制度」への対応に向けた準備等に伴う需要も始めている。

このような状況のもと、機器販売が官公庁向けのほか金融機関やデータセンター向けに堅調な推移となったことなどから、当中間期における売上高は84億4千4百万円(前年同期比21.1%増)、売上高の増加等により、セグメント利益(経常利益)は2億7千2百万円(前年同期比109.5%増)となりました。

③ソフトウェア他 9%

品目別売上高構成比

①ネットワーク関連機器 51%

②ストレージ関連機器 40%

①ネットワーク関連機器

インターネットの接続負荷の分散、
セキュリティ強化



主な仕入れ先

F5ネットワークス社
アリストネットワークス社

②ストレージ関連機器

大容量データの記憶、
統合技術によるコスト削減

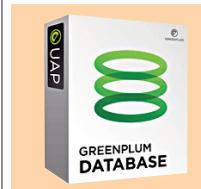


主な仕入れ先

ブロード
コミュニケーションズ
システムズ社
EMC社
ピュアストレージ社

③ソフトウェア他

データ管理を行うデータベース



主な仕入れ先

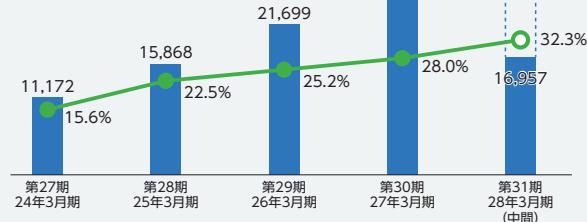
日本オラクル社
ピボタル
ソフトウェア社

Strategy 海外ビジネスとインレミアムビジネスの強化

アジア地域の日経企業向け販売好調

海外ビジネス売上高

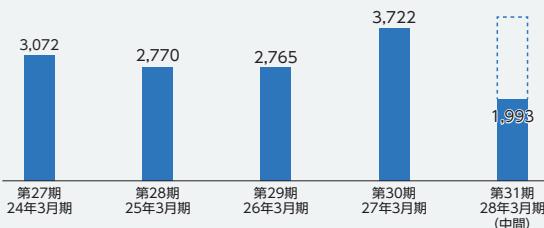
■ 海外連結子会社売上高(単位:百万円)
● 海外連結子会社売上高比率



産業機器向け設計/量産受託サービス堅調

インレミアムビジネス売上高

(単位:百万円)



連結財務諸表

中間(第2四半期) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	前 期 (平成27年3月31日現在)	当第2四半期 (平成27年9月30日現在)
流動資産	63,615	55,379
固定資産	5,833	5,577
資産合計 POINT1	69,449	60,956
流動負債	33,799	27,352
固定負債	12,872	10,690
負債合計 POINT2	46,671	38,042
純資産合計 POINT3	22,777	22,913
負債及び純資産合計	69,449	60,956

POINT1 資産合計

総資産は609億5千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億9千3百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品が減少したことによります。

中間(第2四半期) 連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期累計 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	当第2四半期累計 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)
売上高	53,952	57,143
売上原価	46,606	49,537
売上総利益	7,346	7,605
販売費及び一般管理費	6,773	6,816
営業利益	573	788
経常利益	442	647
特別利益	—	8
特別損失	2	14
法人税等	151	224
親会社株主に帰属する四半期純利益	287	416

POINT2 負債合計

負債総額は380億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億2千9百万円の減少となりました。これは主に、買掛金及び短期借入金が減少したことによります。

POINT3 純資産合計

純資産総額は229億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千5百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は37.6%となり前連結会計年度末に比べ4.8ポイント向上いたしました。

中間(第2四半期) 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)

科 目	前第2四半期累計 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	当第2四半期累計 (平成27年4月1日から 平成27年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,985	5,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128	△ 42
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,898	△ 6,339
現金及び現金同等物の期首残高	1,285	2,302
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,108	1,342

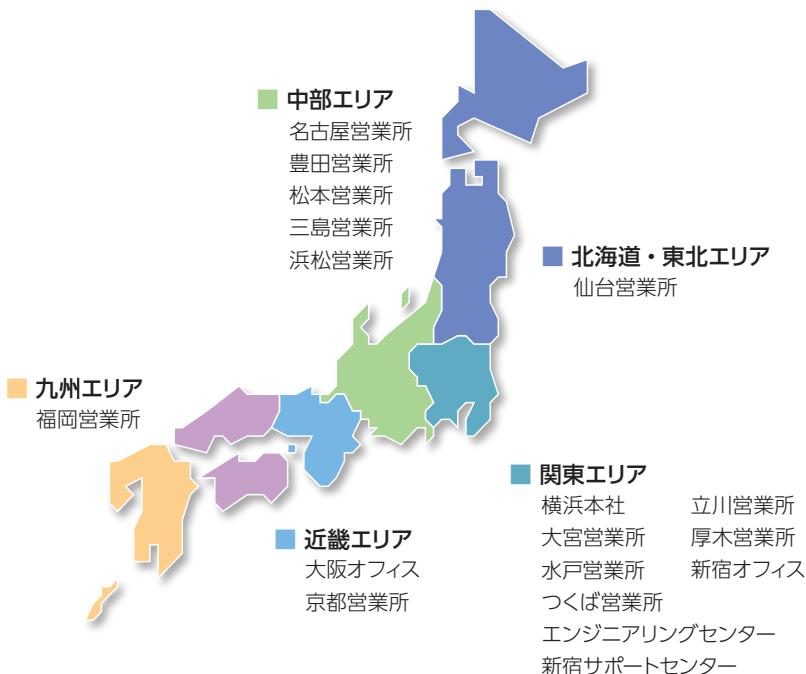
(注) 連結財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

会社の概要 (平成27年9月30日現在)

会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	972名(連結)
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア
グループ会社	パネトロン株式会社 東電電子零件亞太區有限公司 (TED APAC) 上海華桑電子零件貿易有限公司 (TED上海) TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. (TEDシンガポール) TOKYO ELECTRON DEVICE (THAILAND) LIMITED (TEDタイ) inrevium AMERICA, INC. (インレビウムアメリカ) 上海華桑電子有限公司 (インレビウム上海) 無錫華桑電子科技有限公司 (インレビウム無錫) Fidus Systems, Inc.

主な拠点 (国内)



役員等

取締役

代表取締役社長	徳重 敦之
代表取締役副社長	久我 宣之
取締役	天野 勝之
取締役	初見 泰男
取締役	上小川 昭浩
取締役	長谷川 雅巳
取締役	佐伯 幸雄
取締役(非常勤)	常石 哲男
社外取締役	石川 國雄
社外取締役	不破 久温

監査役

常勤監査役	武井 弘
常勤監査役	中村 隆
社外監査役	福森 久美
社外監査役	成瀬 圭珠子

執行役員

社長	徳重 敦之
副社長	久我 宣之
執行役員	初見 泰男
執行役員	上小川 昭浩
執行役員	長谷川 雅巳
執行役員	佐伯 幸雄
執行役員	林 英樹
執行役員	浅野 升徳
執行役員	上善 良直
執行役員	安村 達志
執行役員	篠田 一樹

株式情報 (平成27年9月30日現在)

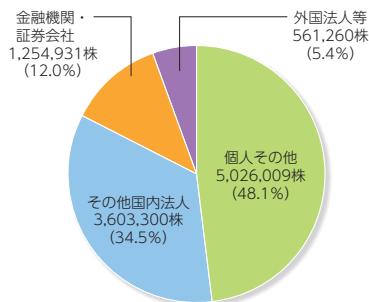
株式の状況

- 発行可能株式総数 25,600,000株
- 発行済株式総数 10,445,500株
- 株主数 7,531名
- 大株主

株主名	持株数	出資比率	
		株	%
東京エレクトロン株式会社	3,532,700		33.82
東京エレクトロンデバイス社員持株会	413,739		3.96
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (従業員持株ESOP信託口・75722口)	293,600		2.81
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	223,800		2.14
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬BIP信託口・75723口)	156,284		1.50

株式分布状況

- 所有者別株式数



株主メモ

- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 定時株主総会 毎年6月
- 基準日 定時株主総会については、毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
- 配当支払株主確定日 期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日
- 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
- (郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
(電話照会先) 三井住友信託銀行株式会社証券代行部
0120-782-031 (フリーダイヤル)
- 同取次所 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
- 公告の方法 電子公告
- 上場金融商品取引所 東京証券取引所 市場第一部
(証券コード 2760)

- 「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は大切に保管ください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。